

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-021

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	申万宏源、富安达基金、天风证券、银河基金、九泰基金、西部利得、大家资产、大成基金、泓德基金、Pinpoint、博裕资本。
时间	2024年7月15日-2024年7月16日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：射频前端芯片产品主要有哪些？ 答：目前公司射频前端芯片产品主要包括射频开关、滤波器、功率放大器（PA）、低噪放（LNA）、双工器等。</p> <p>2. 问：公司主要客户有哪些？ 答：公司主要客户有瑞鼎、集创北方、奕斯伟、云英谷、联咏、格科微、OMNIVISION TOUCH AND DISPLAY、敦泰、通锐微等。</p> <p>3. 问：公司晶圆来源的情况？ 答：公司晶圆来源接近六成来自境内晶圆厂，如 SMIC、晶合集成、粤芯、华虹等，其他则由境外晶圆厂提供，如台积电、力积电、世界先进、UMC 等。</p> <p>4. 问：公司针对非显示业务的后续布局如何？ 答：非显示类芯片的封测业务是未来公司优化产品结构、利润增长和战略发展的重点，公司高度重视非显示类业务的发展。在封测产品方面，公司将把握中国大陆 IC 设计企业在相关领域快速发展的良好契机，继续巩固和加强在电源管理、射频前端等芯片先进封测业务的量产。在已有技术的基础上，公司着力于 12 吋晶圆各类金属凸块技术的深度研发，同时大力发展基于砷化镓、氮化镓、钽酸锂等第二代、第三代半导体材料的凸块制造与封测业务，持续加强后段 DPS 封装业务的建设，提升全</p>

	<p>制程封测能力，进一步降低生产成本，逐步克服在非显示芯片封测业务的后发劣势。</p> <p>5. 问：公司技术改造方面的优势是什么？</p> <p>答：公司具备技术改造和硬件开发的优势，公司一直致力智能制造的投入与专业人才的培养，拥有一支 20 余人的专业化团队，具备较强的核心设备改造、配件设计以及自动化系统开发能力。在核心设备改造方面，公司自主设计并改造了一系列适用于 125mm 大版面覆晶封装的相关设备，为大版面覆晶封装产品的量产奠定了坚实基础，并自行完成了核心 8 吋 COF 设备的技术改造以用于 12 吋产品，大幅节约了新设备购置所需的时间和成本。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 16 日